【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第６区分
【発行日】令和7年4月24日(2025.4.24)

【公開番号】特開2024-124497(P2024-124497A)
【公開日】令和6年9月12日(2024.9.12)
【年通号数】公開公報(特許)2024-172
【出願番号】特願2024-107967(P2024-107967)
【国際特許分類】
Ｂ６５Ｄ 85/86(2006.01)
Ｂ６５Ｄ 65/40(2006.01)
Ｂ６５Ｄ 85/90(2006.01)
【ＦＩ】
Ｂ６５Ｄ 85/86 ３００
Ｂ６５Ｄ 65/40 Ｄ
Ｂ６５Ｄ 85/90

【手続補正書】
【提出日】令和7年4月16日(2025.4.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
幅が３ｍｍ以下の長尺状であり、
ＪＩＳ Ｋ ６７３４に従い測定される破断強度が１０Ｎ以上であり、
少なくとも、基材層と、中間層と、シーラント層と、をこの順に備え、
前記基材層は、ナイロン樹脂を含む層と、ポリエステル樹脂を含む層と、の少なくとも２層を含み、
樹脂製キャリアテープの表面にヒートシール法により接着して電子部品包装体を作製するために用いられる、電子部品包装用カバーテープ（ただし、基材層と、中間層と、シーラント層とがこの順に積層し、当該シーラント層によりキャリアテープをシールするために用いられる、カバーテープであって、前記シーラント層はスチレン系樹脂およびポリ（メタ）アクリル酸誘導体を含み、前記スチレン系樹脂中のスチレン含有率は１５質量％以上である、カバーテープを除く）。
【請求項２】
請求項１に記載の電子部品包装用カバーテープであって、
１００５サイズ以下の電子部品の包装に用いられる、電子部品包装用カバーテープ。
【請求項３】
請求項１または２に記載の電子部品包装用カバーテープであって、
前記中間層が、低密度ポリエチレンを含む、電子部品包装用カバーテープ。
【請求項４】
請求項１～３のいずれか１項に記載の電子部品包装用カバーテープであって、
前記中間層の、２３℃における寸法をＴ$_0$とし、８０℃で２時間加熱した後の寸法をＴ$_1$としたとき、以下の式（１）で表される、前記中間層の流れ方向（ＭＤ方向）の寸法変化率が－４～４％であり、幅方向（ＴＤ方向）の寸法変化率が０～２％である、電子部品包装用カバーテープ。
寸法変化率（％）＝｛（Ｔ$_0$－Ｔ$_1$）／Ｔ$_0$｝×１００ 式（１）

【請求項５】
電子部品が格納されたキャリアテープと、前記電子部品を封止するように前記キャリアテープに接着された請求項１～４のいずれか一項に記載の電子部品包装用カバーテープと、を備える電子部品包装体。
【請求項６】
請求項５に記載の電子部品包装体であって、
前記電子部品が、０４０２サイズ以下の電子部品である、電子部品包装体。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４９】
以上、本発明の実施形態について述べたが、これらは本発明の例示であり、上記以外の様々な構成を採用することができる。また、本発明は上述の実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成できる範囲での変形、改良等は本発明に含まれる。
以下、参考形態の例を付記する。
１．
幅が３ｍｍ以下の長尺状であり、
ＪＩＳ　Ｋ　６７３４に従い測定される破断強度が１０Ｎ以上である、電子部品包装用カバーテープ。
２．
１．に記載の電子部品包装用カバーテープであって、
１００５サイズ以下の電子部品の包装に用いられる、電子部品包装用カバーテープ。
３．
１．または２．に記載の電子部品包装用カバーテープであって、
少なくとも、基材層と、中間層と、シーラント層と、をこの順に備える、電子部品包装用カバーテープ。
４．
３．に記載の電子部品包装用カバーテープであって、
前記基材層は、ナイロン樹脂、ポリエステル樹脂およびポリプロピレン樹脂からなる群より選ばれる少なくともいずれかを含む、電子部品包装用カバーテープ。
５．
３．または４．に記載の電子部品包装用カバーテープであって、
前記基材層は、ナイロン樹脂を含む、電子部品包装用カバーテープ。
６．
３．～５．のいずれか１つに記載の電子部品包装用カバーテープであって、
前記基材層は、ナイロン樹脂を含む層と、ポリエステル樹脂を含む層と、の少なくとも２層を含む、電子部品包装用カバーテープ。
７．
３．～６．のいずれか１つに記載の電子部品包装用カバーテープであって、
前記中間層が、低密度ポリエチレンを含む、電子部品包装用カバーテープ。
８．
３．～７．のいずれか１つに記載の電子部品包装用カバーテープであって、
前記中間層の、２３℃における寸法をT_0とし、８０℃で２時間加熱した後の寸法をT_1としたとき、以下の式（１）で表される、前記中間層の流れ方向（ＭＤ方向）の寸法変化率が－４～４％であり、幅方向（ＴＤ方向）の寸法変化率が０～２％である、電子部品包装用カバーテープ。
$$寸法変化率（\%）＝\{（T_0－T_1）／T_0\}\times１００\quad\quad式（１）$$
９．

電子部品が格納されたキャリアテープと、前記電子部品を封止するように前記キャリアテープに接着された１．～８．のいずれか一つに記載の電子部品包装用カバーテープと、を備える電子部品包装体。

１０．

９．に記載の電子部品包装体であって、

前記電子部品が、０４０２サイズ以下の電子部品である、電子部品包装体。